ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНАЛОГОВЫХ МИКРОСХЕМ НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО МАТРИЧНОГО КРИСТАЛЛА MH2XA031

O.B. Дворников, B. A. Чеховский oleg_dvornikov@tut.by

Элементы БМК МН2ХА031 двухзатворный JFET.

В конструкциях обычных JFET используется изменение сопротивления канала за счет уменьшения толщины токопроводящей части канала при одновременном расширении областей пространственного заряда двух обратносмещенных

р-п-переходов. Для интегральных JFET из-за особенностей формирования полупроводниковых слоев с разным типом проводимости, концентрация примеси в нижнем затворе (bottom gate, BG), залегающим в объеме полупроводника, обычно намного меньше, чем в верхнем (top gate, TG), контактирующем с поверхностью. По указанной причине, крутизна верхнего затвора намного больше, чем нижнего. Другой особенностью интегральных JFET является то, что площадь p-n-перехода нижний затвор-канал больше, чем верхний затвор-канал. Кроме того, с нижним затвором соединен p-n-переход, изолирующий JFET элементов, ОТ других расположенных на полупроводниковой подложке. Следствием рассмотренных конструктивных особенностей является большая емкость и обратный ток нижнего затвора.

Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что статические параметры интегральных JFET, изготовленных в ОАО «ИНТЕГРАЛ», крайне незначительно изменяются при воздействии флюенса быстрых электронов до 10¹⁴ эл./см² с энергией 6 МэВ и поглощенной дозе гамма-квантов ⁶⁰Со до 3 Мрад, причем основным критерием радиационной стойкости JFET для применения в аналоговых ИМС является допустимая величина обратного тока затвора.

Следовательно, стойкости для повышения радиационной И быстродействия аналоговых ИМС с JFET целесообразно применение двухзатворного JFET (double gate JFET, DG JFET) с управлением верхним затвором. Более того, при использовании DG JFET во входном каскаде ИМС возможно применение «паразитного» BiT, в котором коллектором является верхний затвор, базой – исток, а эмиттером – нижний затвор, для уменьшения падения напряжения на резисторах, вызванного протеканием по НИМ постоянного входного тока. Последнее достигается тем, что при включении «паразитного» BiT в прямом направлении входной ток протекает в его коллектор, а не по резисторам, соединенном с верхним затвором.

Конструкция DG JFET была разработана для применения в радиационностойком БМК МН2ХА031, изготовленном по технологическому маршруту «ИНТЕГРАЛ», формировать 3CBiT OAO позволяющему на одной 1) полупроводниковой подложке p-JFET (рис. И комплементарные вертикальные ВіТ.



Рис. 1. Типовая структура p-JFET по технологическому маршруту 3CBiT OAO «ИНТЕГРАЛ»

Особенностями разработанного DG JFET являются:

1) Минимизация емкости стока и сопротивления истока, благодаря топологии с центрально расположенным стоком, окруженным со всех сторон верхним затвором и истоком. Такую конструкцию рекомендуется применять в усилительных каскадах с общим истоком, в которых сопротивление полупроводниковой области истока уменьшает крутизну JFET и, следовательно, усиление напряжения, а емкость стока усиливается эффектом Миллера.

2) Уменьшение обратного тока верхнего затвора за счет минимизации площади p-n-перехода верхний затвор-канал и устранения областей с максимальной кривизной и, таким образом, максимальной напряженностью электрического поля.

3) Уменьшение сопротивления полупроводниковой области n-верхнего затвора вследствие контактирования металлического межсоединения с областью верхнего затвора по всей ее протяженности.

4) Формирование межсоединений с шириной (4,5 мкм) и зазором (1,5 мкм) соответствующими сетке, принятой на БМК. Окна всех элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов, изолирующих карманов) на БМК расположены таким образом, что любой металлический проводник, шириной 4,5 мкм, либо покроет окно с требуемым перекрытием, либо будет расположен от ближайшего проводника с требуемым зазором в 1,5 мкм.

5) Глубина залегания (толщина) полупроводниковых областей (рканал, п-эпитаксиальный слой, п+-скрытый слой) выбрана таким образом, чтобы при увеличении напряжения на обратносмещенном p-n-переходе нижний затвор-канал область пространственного заряда этого перехода вначале распространялась преимущественно в эпитаксиальный слой, а затем, дойдя до n+-скрытого слоя, начинала распространяться в p-канал. Таким способом в разработанной конструкции уменьшается напряжение отсечки нижнего затвора. Последнее свойство очень важно для аналоговых ИМС с малым напряжением питания.

Для изготовленных образцов DG JFET была изучена передаточная вольтамперная характеристика (BAX), т.е. зависимость тока стока I_D от

напряжения затвор-исток V_{GS} при различном напряжении нижний затвор-исток V_{BGS} или верхний затвор-исток V_{TGS} (рис. 2, 3), а также зависимость отношения крутизны g_M к I_D от тока стока или напряжения затвор-исток.



Рис. 2. Передаточная ВАХ DG JFET: 1- с соединенными затворами, 2- управление верхним затвором и *V*_{BGS}=0, 3- управление нижним затвором и *V*_{TGS}=0



Рис. 3. Передаточная ВАХ DG JFET при управлении верхним затвором: 1-*V_{BGS}*=0, 2-*V_{BGS}*=1 В, 3-*V_{BGS}*=2 В, 4-*V_{BGS}*=3 В

Как следует из результатов измерений максимальная крутизна и напряжение отсечки V_{TH} верхнего затвора составляют 5,58 мА/В и 5,1 В, а нижнего - 3,72 мА/В и 7,5 В. Обратный ток верхнего и нижнего затворов близки по величине и не превышают $5 \cdot 10^{-12}$ А, однако площадь верхнего затвора почти в 8,3 раза меньше, чем нижнего. Можно предложить, что измеренные значения обратного тока определяются возможностями применяемого измерительного прибора ИППП-1 и, в большей степени, сопротивлением изоляции металлокерамических корпусов H16.48-1BH, в которые были собраны образцы DG JFET.

Полученные экспериментальные зависимости $g_M / I_D = f(I_D)$ и $g_M / I_D = f(V_{GS})$ позволяют сформулировать следующие рекомендации:

•наилучшим режимом работы JFET, обеспечивающим максимальное усиление напряжения при минимальном токе потребления за счет большой величины g_M/I_D , является режим работы при напряжении затвор-исток вблизи напряжения отсечки,

•реализация указанного режима дополнительно обеспечивает температурную стабильность рабочей точки, достигаемую обычно при $|V_{GS}| = |V_{TH}|$ -0,66 B, но уменьшает допустимый диапазон рабочего напряжения ИМС за счет относительно большого падения напряжения на обратносмещенном переходе затвор-исток,

•наиболее целесообразно применение DG JFET при постоянном обратном напряжении на нижнем затворе, что одновременно обеспечивает высокое отношение g_M/I_D и большой допустимый диапазон рабочего напряжения.

На основе результатов измерений создана электрическая модель (рис. 4) DG JFET, удовлетворительно описывающая его BAX. Кроме выводов истока S, стока D, верхнего Tg и нижнего Bg затворов на рис. 4 изображен вывод Sub подложки р-типа, который должен быть соединен с самым низким напряжением схемы.



Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема DG JFET в LTSpice

Элементы БМК MH2XA031: высокоомные полупроводниковые резисторы.

Интегральные резисторы обычно применяют для установки рабочей точки транзисторов ИМС, поэтому температурные коэффициенты сопротивлений обязательно учитываются при схемотехническом проектировании.

Исследования температурных зависимостей сопротивлений разных полупроводниковых областей были выполнены ранее для типового диапазона температур эксплуатации ИМС, примерно от минус 60 °C до +125 °C.

В последнее время появились исследования резисторов, сформированных на различных полупроводниковых материалах, и сопротивлений каналов полевых транзисторов при криогенных температурах.

Выполненные нами криогенные измерения ВАХ элементной базы ИМС, изготовленных по техмаршруту 3CBiT, показали значительное увеличение сопротивления полупроводниковых резисторов р-типа проводимости при температуе минус 197 °C, приводящее к резкому уменьшению тока потребления и ухудшению параметров микросхем.

В сложившейся ситуации, одной из задач проводимых работ стала разработка конструкции высокоомного резистора для работы при температуре

менее минус 100 ^оС без значительного изменения технологического маршрута изготовления кремниевых ИМС.

На основе выполненнных экспериментальных исследований (рис. 5) в качестве высокоомных резисторов нами предложено использование «пинчрезисторов» (pinch resistors), т.е. JFET с соединенными выводами затвора и истока, работающие в линейной области ВАХ при напряжении на резисторе значительно меньшем напряжения отсечки JFET.

Так, на рис. 5 показаны зависимости нормированного сопротивления (отношения сопротивления резистора при текущей температуре к его значению при 20 °C) от температуры для различных интегральных резисторов: 1 - полупроводникового резистора р-типа проводимости техмаршрута 3СВіТ; 3 - «пинч-резистора» на p-JFET техмаршрута 3CBiT; 2, 4 - «пинч-резисторов» соответственно на p-JFET и n-JFET разных техмаршрутов изготовления «ИНТЕГРАЛ». микросхем OAO Изменение биполярно-полевых сопротивления «пинч-резисторов» в диапазоне температур от минус 197 °С до 20 °C примерно в 3 раза меньше, чем полупроводникового резисторов. Заметим, что при использовании «пинч-резисторов» необходимо учитывать наличие нелинейности их ВАХ (рис. 6), особенно значительной при низких температурах из-за уменьшения напряжения отсечки JFET.





Рис. 5. Зависимость нормированного сопротивления интегральных резисторов от температуры

Рис. 6. Зависимость сопротивления «пинчрезистора» техмаршрута 3CBiT от падения напряжения на нем: 1– при минус 197 °C, 2 – при 20 °C

Нелинейность BAX «пинч-резисторов» может быть уменьшена благодаря последовательному соединению нескольких резисторов и уменьшению, таким образом, падения напряжения на каждом из них.

При схемотехническом моделировании для адекватного описания ВАХ «пинч-резистора» вполне достаточно применение модели Шихмана-Ходжеса с предложенной методикой учета низких температур.

Модернизированный базовый матричный кристалл МН2ХА031.

Результаты выполненных работ использованы в конструкции и библиотеке Spice-параметров модернизированного БМК МН2ХА031, отличие которого от исходного заключается в следующем:

•малошумящие p-JFET заменены на пару DG JFET, расположение которых на топологии позволяет их использовать как входные транзисторы дифференциальных каскадов (ДК) с соединенными или раздельными затворами, либо в качестве одного p-JFET с увеличенной крутизной,

•размещение на топологии многоэммиттерных n-p-n- и p-n-pтранзисторов выполнено способом, упрощающим их применение в ДК с малошумящими BiT,

•окна всех элементов БМК соответствуют сетке межсоединений шириной 4,5 мкм и зазором в 1,5 мкм,

•топология p-JFET откорректирована для упрощения реализации «пинч-резисторов»,

•для увеличения радиационной стойкости вертикальный p-n-pтранзистор выполнен в отдельном изолированном кармане n-типа проводимости, соединенном с эмиттером.

Одним из главных преимуществ модернизированного БМК является апробированная библиотека Spice- параметров интегральных элементов, включающая идентифицированные параметры DG JFET для предложенной модели, что допускает применение DG JFET при синтезе и схемотехническом моделировании аналоговых ИМС. Кроме того, модели всех активных элементов удовлетворительно описывают изменение BAX в диапазоне температур до минус 197 °C, при воздействии гамма-квантов с поглощенной дозой до 3 Мрад, флюенса нейтронов до 10¹⁵ н./см². При моделировании не учитывается только радиационное изменение тока затвора p-JFET. Результаты моделирования основных зависимостей для BiT, отражающие влияние внешних воздействий, показаны на рис. 7-9.



Рис. 7. Зависимость коэффициента усиления базового тока β транзисторов MH2XA031 от эмиттерного тока при температуре 20 ⁰C: 1 — n-p-n; 2 — p-n-p



Рис. 8. Зависимость коэффициента усиления базового тока транзисторов MH2XA031 от эмиттерного тока при температуре минус 197 ^оС: 1 — n-p-n; 2 — p-n-p



Рис. 9. Зависимость коэффициента усиления базового тока транзисторов MH2XA031 от эмиттерного тока при температуре 20 0 С и потоке нейтронов $F_{N}=10^{15}$ н./см²: 1 — n-p-n; 2 — p-n-p

Операционный усилитель со встроенной обратной связью по синфазному сигналу.

В операционном усилителе (ОУ) OAmp2, схема которого показана на рис. 10, а упрощенная топология межсоединений - на рис. 11, в отличие от исходной схемы OAmp1 реализована обратная связь (OC) по синфазному сигналу за счет введения дополнительного ДК на транзисторах Q29-Q34, сравнивающего сигнал с выхода резистивного делителя, включенного между парафазными выходами OУ, и выводом FB. Все узлы на рис. 10 с одинаковым наименованием (Vcc, Vee, N1, N2, P1, P2) соединены между собой. В узлы Biasn, Biasp поступает напряжение от не показанного на рис. 10 блока смещения. Если напряжение в узле FB отличается от напряжения на базах Q31, Q34, то коллекторные токи Q29, Q30, Q32, Q33 изменяются и изменяют напряжение на коллекторах Q3, Q4, выходах Out1, Out2 до тех пор, пока напряжение в узле FB не станет равным выходному напряжению резистивного делителя R20, R21.



Рис. 10. Упрощенная электрическая схема ОУ ОАтр2



Рис. 11. Упрощенная топология межсоединений ОАтр2 на БМК МН2ХА031

Действие ОС по синфазному сигналу приводит к уменьшению напряжения смещения нуля V_{OFF} , вызванному технологическим разбросом параметров интегральных элементов и/или внешними воздействиями. Измерения экспериментальных образцов показали, что V_{OFF} усилителя OAmp2 почти в 10 раз меньше, чем подобного ОУ без ОС по синфазному сигналу.

Более того, малое значение V_{OFF} сохраняется при воздействии флюенса быстрых электронов до $3,7 \times 10^{14}$ эл./см² с энергией 6 МэВ и начинает увеличиваться только при больших флюенсах быстрых электронов из-за существенного падения β биполярных транзисторов.

Встроенная ОС по синфазному сигналу позволяет также без применения дополнительных интегральных элементов реализовать новую, необходимую в аналоговых интерфейсах датчиков функцию – сдвиг постоянного уровня выходного напряжения ОУ.

Дополнительными преимуществами OAmp2 являются малый температурный дрейф напряжения смещения нуля $\Delta V_{OFF}/\Delta T \approx 4,4$ мкB/⁰C (в диапазоне температур от минус 60 °C до 125 °C) и встроенная частотная коррекция, обеспечивающая при частоте единичного усиления в 60 МГц запас фазы 38 градусов. Заметим, что при разомкнутой цепи OC K_V>70 дБ.

Мультидифференциальный Операционный усилитель.

Для применения в космической аппаратуре на элементах БМК МН2ХА030 был разработан мультидифференциальный операционный усилитель (МОУ) ОАтр3, измерения которого выявили потерю работоспособности при температурах менее минус 150 °C, вызванную значительным увеличением сопротивления полупроводниковых резисторов.

В разработанном на БМК МН2ХА031 модернизированном МОУ ОАтр8, показанном на рис. 12, 13, для обеспечения работоспособности при температуре минус 197 ^оС высокоомные полупроводниковые резисторы заменены на «пинч-резисторы».

МОУ OAmp8, как и исходный OAmp3, состоит из трех усилительных каскадов.

В первом каскаде, выполненном по схеме перегнутого каскода на транзисторах с общей базой (ОБ) Q1, Q2, нагрузкой которых являются «пинчрезисторы» J7, J9, применяется суммирование токов стока двух входных ДК J2, J3 и J5, J6 на резисторах J12, J13. Вторым усилительным каскадом является ДК на J10, J11 с нагрузкой в виде «токового зеркала» Q3, Q4. Третий усилительный каскад образует транзистор с общим эмиттером Q5 с нагрузкой J14. Истоковый повторитель J16 с источником тока J15 и транзисторами Q6–Q11 представляет собой двухтактный выходной каскад.

Схемотехническое моделирование основных параметров OAmp8 проводилось в программном обеспечении LTSpice для моделей интегральных элементов БМК MH2XA031, достаточно адекватно описывающих температурные и радиационные изменения BAX (см. рис. 7-9).



Рис. 13. Упрощенная топология межсоединений ОАтр8 на БМК МН2ХА031

Моделирование позволило установить:

- применение «пинч-резисторов» привело к уменьшению тока потребления *I*_{CC} в 2,16 раза при температуре минус 197 ⁰С по сравнению с 20 ⁰С, хотя для исходного МОУ (ОАтр3) в указанном диапазоне температур изменение *I*_{CC} составляло 31 раз,
- температурное изменение *I*_{CC} качественно совпадает с изменением максимального тока стока JFET, который возрастает по абсолютной

величине при уменьшении температуры до минус 90 0 C ... минус 110 0 C, а затем резко уменьшается,

- полученное температурное изменение напряжения смещения нуля V_{OFF} (рис. 14) и коэффициента усиления напряжения без цепи обратной связи K_V (рис. 15) допустимо для большинства применений МОУ в аналоговых схемах,
- при воздействии флюенса нейтронов 10¹⁵ н./см² I_{CC} уменьшается до 366 мкА по сравнению с 1,44 мА в нормальных условиях, но K_V в режиме холостого хода превышает 110 дБ, что обусловлено предельно малым радиационным изменением ВАХ р-JFET, в то время как радиационное падение β биполярных транзисторов сказывается, в основном, на ухудшении нагрузочной способности.



 Рис. 14. Зависимость систематической составляющей напряжения смещения нуля ОАтр8 от температуры



• Рис. 15. Зависимость коэффициента усиления напряжения ОАтр8 от температуры

Зарядочувствительный усилитель с входным двухзатворным JFET.

Наиболее целесообразно применение DG JFET БМК МН2ХА031 в тех аналоговых ИМС, основные параметры которых сильно зависят от величины входной емкости и/или входного тока. Примером такой схемы может служить

зарядочувствительный усилитель (ЗЧУ), оценку основных параметров которого можно осуществить с помощью выражений:

$$\tau_{R} = \left(C_{D} + C_{STR} + C_{INP}\right) \frac{C_{\Sigma}}{C_{F} g_{M}},\tag{1}$$

$$ENC_{S}^{2} = N(C_{D} + C_{STR} + C_{INP} + C_{F})^{2} \frac{1}{g_{M}},$$
(2)

где τ_R — длительность фронта нарастания выходного сигнала; ENC_S — последовательная составляющая эквивалентного шумового заряда; C_D , C_{STR} — внутренняя емкость датчика (источника входного сигнала) и паразитная емкость, соединенные с входом ЗЧУ; C_{INP} — входная емкость ЗЧУ; C_{Σ} — суммарная емкость всех параллельных цепей, соединенных с высокоимпедансным узлом ЗЧУ в виде перегнутого каскода; C_F — емкость в цепи ОС; g_M — крутизна входного транзистора ЗЧУ; N — переменная, зависящая от температуры и параметров полосового фильтра, соединенного с выходом ЗЧУ.

Как следует из (1), (2) в качестве входного транзистора ЗЧУ целесообразно применять JFET с высоким отношением g_M/C_{INP} , которое достигается в DG JFET.

Схемотехническое моделирование выполнялось в LTSpice для ЗЧУ в виде перегнутого каскода, показанного на рис. 16, 17. Отличие схемы рис. 17 от ранее рассмотренных заключается в замене входного обычного p-JFET на двухзатворный с возможностью соединения нижнего затвора BG с входом Inp или с источником постоянного напряжения V_{BGS} .

При моделировании напряжение источников питания составляло ± 5 В, температура – 20 0 C, ток стока J2 – 5,78 мА. Транзистор J2 состоял из 19-ти параллельно соединенных DG JFET. При указанных условиях крутизна J2 с соединенными затворами на 50,8% больше, чем при управлении верхним затвором и $V_{BGS}=2$ В, однако суммарная емкость, подключенная к затвору при соединенных затворах, в 18,5 раз больше, чем при управлении одним верхним затвором. Как следует из результатов моделирования, приведенных на рис. 18, 19, управление верхним затвором привело к уменьшению уровня шумов ЗЧУ в 2,15 раза и увеличению быстродействия в 9,47 раз при малой емкости датчика $(C_D=1 \text{ п}\Phi)$, хотя при $C_D>300 \text{ п}\Phi$ предпочтительнее применять DG JFET с соединенными затворами. Ранее отмечалось, что одним из преимуществ DG JFET является возможность применения «паразитного» BiT для уменьшения падения напряжения на резисторах, вызванного протеканием по ним постоянного входного тока. К сожалению, эта функция допустима только для одного направления входного тока. Так, при применении в качестве входного транзистора двухзатворного p-JFET возможна компенсация влияния постоянного тока *I*_{INPDC} только втекающего в вывод Inp.



Рис. 16. Электрическая схема ЗЧУ с двухзатворным p-JFET на основе БМК MH2XA031



Рис. 17. Упрощенная топология межсоединений ЗЧУ (рис.16) на БМК МН2ХА031



Рис. 18. Зависимость длительности фронта нарастания τ_R от емкости датчика C_D при разном включении DG JFET: 1- затворы соединены, 2- управление верхним затвором и



Рис. 19. Зависимость эквивалентного шумового заряда *ENC* (в электронах) от емкости датчика *C*_D при разном включении DG JFET: 1- затворы соединены, 2- управление верхним затвором и *V*_{BGS}=2 В

Главное назначение такой схемы компенсации заключается в обеспечении выходного напряжения ЗЧУ близкого нулю при применении биполярных источников питания и большом сопротивлении резистора ОС (RF на рис. 16), падение напряжения на котором обусловлено протеканием *I*_{INPDC}.

Простейшая реализация схемы компенсации входного тока заключается во включении между выводами BG и V_{EE} резистора R_{EXT} , сопротивление которого выбирается в зависимости от величины I_{INPDC} .

Схемотехническое моделирование подтвердило эффективность компенсации постоянного входного тока ЗЧУ. Так, при RF=10 МОм, $V_{EE}=5$ В близкое к нулю выходное напряжение ЗЧУ при отсутствии входного импульса достигается при $R_{EXT}=58$ МОм для $I_{INPDC}=0,1$ мкА и $R_{EXT}=4,57$ МОм при $I_{INPDC}=1$ мкА.

Компаратор АДСотр3.

Электрическая схема компаратора ADComp3 показана на рис. 20.



Рис. 20. Электрическая схема компаратора ADComp3

Отличие электрической схемы компаратора ADComp3 от предыдущих изделий заключается в том, что для уменьшения энергопотребления значительно уменьшены рабочие токи транзисторов за счет увеличения сопротивления эмиттерных резисторов и снижено напряжение питания до ± 3 В путем замены стабилитронов в каскадах сдвига уровня на цепи последовательно соединенных диодов. В то же время для обеспечения требуемого уровня максимального выходного тока I_{OUT} по выходам Out1, Out2 и возможности, при необходимости, его уменьшения введена подстройка величины I_{OUT} с помощью соединения вывода Rb1с через внешний резистор с шиной нулевого напряжения или положительного напряжения питания V_{CC} . Заметим, что диоды были реализованы на p-JFET только из-за наличия достаточного количества p-JFET на полупроводниковом кристалле.

Принятые меры позволили в нормальных условиях уменьшить ток потребления компаратора от положительного источника питания до I_{CC} =0.98 мА (I_{CC} – ток потребления компаратора без выходного каскада на Q11, Q12), при этом входной ток составил I_{INP} =0.6 мкА, а I_{OUT} =4.2 мА.

Радиационная стойкость компонентов БМК МН2ХА031.

Радиационную стойкость ADComp3 характеризуют результаты моделирования при напряжении источников питания ± 3 В и соединении выходов Out1, Out2 через резисторы 50 Ом с шиной нулевого напряжения, показанные на рис. 21-24.

Несмотря на уменьшение I_{OUT} и значительный рост I_{INP} можно рекомендовать применение ADComp3 при воздействии флюенса нейтронов до 10^{14} н./см². При этом надо учитывать, что влияние поглощенных гамма-квантов на параметры компаратора намного слабее, чем нейтронов. Ориентировочно, изменение параметров компаратора при $D_G=3$ Мрад близко к такому же изменению параметров при воздействии $F_N=3\cdot10^{13}$ н./см².



Рис. 23. Зависимость входного тока I_{INP} компаратора от потока нейтронов $F_{\rm N}$



Рис. 22. Зависимость максимального выходного тока І_{ОUT} компаратора от потока нейтронов F_N



Рис. 24. Зависимость входного тока I_{INP} компаратора от поглощенной дозы гамма-излучения D_G

Функционирование OAmp2 при воздействии проникающей радиации (ПР) иллюстрируют результаты моделирования OУ при включении по схеме неинвертирующего усилителя напряжения с коэффициентом усиления, равным 5 (рис. 25), и зависимости входного тока и коэффициента усиления K_V от флюенса нейтронов (рис. 26, 27).

Хотя OAmp2 сохраняет свою работоспособность при $F_N=10^{14}$ н./см², с нашей точки зрения, целесообразно его применение в области достаточно больших K_V и малых значений I_{INP} , т.е. до 10^{13} н./см². Воздействие гамма-квантов на параметры OAmp2 намного слабее и можно рекомендовать его применение до 3 Мрад.



Рис. 25. Напряжение на выходе Out1 при включении OAmp2 по схеме неинвертирующего усилителя напряжения с коэффициентом усиления, равным 5: 1 – в нормальных условиях, 2 – при F_N=10¹⁴ н./см², 3 – при F_N=2·10¹⁴ н./см²



В МОУ ОАтр8 применены n-p-n BJT и p-JFET с высоким уровнем радиационной стойкости, менее радиационно-стойкие p-n-p-транзисторы использованы только в выходном каскаде, поэтому в режиме холостого хода усиление напряжения этого МОУ достаточно высокое до флюенса нейтронов 10¹⁴ н./см². При потоках нейтронов более 10¹⁴ н./см² моделирование следует повторить после экспериментальной апробации моделей в этом диапазоне воздействия ПР.





Рис. 29. Зависимость тока потребления I_{CC} ОАтр8 от потока нейтронов F_N

Радиационную стойкость ЗЧУ лучше всего описывают результаты моделирования (рис. 30) выходного импульса напряжения (напряжения в узле Out) при поступлении на вход Inp токового импульса в виде "дельта-функции" с зарядом Q_{INP}=100 фКл при емкости датчика, подключенного к входу, C_D=100 пФ, и соединение вывода нижнего затвора (узел BG) с шиной нулевого напряжения.



Для наглядного сравнения результатов моделирования, выходные импульсы в нормальных условиях и при воздействии $F_N=10^{14}$ н./см² приведены со сдвигом по постоянному уровню напряжения.

Моделирование позволяет сделать следующие выводы:

- постоянный уровень выходного напряжения ЗЧУ в нормальных условиях составляет плюс 18.464 мВ, а при воздействии $F_N=10^{14}$ н./см² – плюс 480.683 мВ. Изменение этого уровня обусловлено уменьшением коэффициента усиления тока ВЈТ выходного каскада, т.к. даже возможное значительное увеличение обратного тока верхнего затвора, составляющего в нормальных условиях менее 10^{-12} А, не вызовет существенного падения напряжения на резисторе обратной связи RF=10 МОм;

- уменьшение амплитуды выходного импульса с 95.35 мВ до 90.46 мВ и увеличение длительности фронта нарастания с 39.62 нс до 60.77 нс при воздействии флюенса 10¹⁴ н./см² не является критичным во многих случаях использования ЗЧУ.

Таким образом, можно утверждать, что ЗЧУ с входным DG JFET работоспособен при $F_N=10^{14}$ н./см².